

行業概覽

本節及本文件其他章節所載之資料及統計數據，均摘錄自本公司委聘編製之弗若斯特沙利文報告，以及各項官方政府刊物及公開市場研究可取得之資料。本公司就[編纂]事宜，委聘弗若斯特沙利文編製該報告。來自官方政府渠道之資料，並未經獨家保薦人、[編纂]、彼等各自之任何董事及顧問，或參與[編纂]之任何其他人士或各方獨立核實，且概不就其準確性作出任何聲明。

全球電子布市場概覽

電子布是由電子紗經過整經、漿紗、織造而成的平紋結構織物，具有絕緣、高強度、高耐熱、高耐化學性、高耐燃性等優點，可提供雙向或多向增強效果，屬於電子工業重要的基礎性材料。電子布作為生產覆銅板及印製電路板的基礎原材料，廣泛應用於AI及高性能計算、高端消費電子、汽車電子及智能駕駛、網絡通信等各個應用領域。

根據玻璃類型劃分，電子布可分為普通電子布和特種電子布。普通電子布是印製電路板的基礎材料，其介電常數(Dk)和介電損耗相對較高，難以滿足超高速、高頻傳輸的要求，主要包括厚布、薄布、超薄布和極薄布。特種電子布指為滿足人工智能與高性能計算、網絡通信、先進IC封裝基板等高端應用需求，在常規電子布基礎上通過玻纖材料、紗線結構與織造工藝等定製化設計，實現低介電損耗、低熱膨脹、高均勻性及高可靠性等關鍵性能提升的功能型電子布，主要包括低Dk/Df布、低CTE布及石英玻璃纖維布，常被使用於AI服務器、數據中心、高端通信基站等應用場景。

不同產品類型的電子布的對比分析

	普通電子布				特種電子布		
	厚布	薄布	超薄布	極薄布	低Dk/Df布	低膨脹系數布	石英玻璃纖維布
玻纖纖維類型	電子玻璃厚紗	電子玻璃薄紗	電子玻璃超細紗	電子玻璃極細紗	低Dk/Df紗	低CTE紗	高純石英纖維 (SiO ₂ ≥99.95%)
特性	厚度大於100μm	厚度為36μm~100μm	厚度通常在28μm~35μm，輕薄且平整	厚度小於28μm，極高的尺寸穩定性	低Dk/低Df，減少信號傳輸損耗與延遲，介電損耗可低至0.0015~0.003	低CTE，良好的尺寸穩定性，熱膨脹系數(CTE)可低至2.80~3.50×10 ⁻⁶ /°C	損耗系數低至0.0005~0.0007
技術壁壘	均勻性控制較難	織造穩定性低、易斷裂	拉絲工藝難度大，織造精度要求高	張力控制及織造精度要求高	拉絲工藝難度大，樹脂結合要求高	玻纖製備複雜度高，張力控制難度高	織造工藝難度大，表面處理技術要求高，產能十分受限

行業概覽

	普通電子布				特種電子布		
	厚布	薄布	超薄布	極薄布	低Dk/Df布	低膨脹系數布	石英玻璃纖維布
應用的PCB類型	單層／雙層PCB	多層PCB板	高階HDI PCB板、 高多層PCB板	先進IC封裝基板、 高階HDI PCB板、 高多層PCB板	高多層PCB板、高階HDI PCB板	先進IC封裝基板	高多層PCB板，高階HDI PCB板
應用場景	通用家電、汽車電子	汽車電子、消費電子、 網絡通信	高端消費電子產品等	高端消費電子產品等	AI及高性能計算及高 端通信	AI及高性能計算、高 端消費電子及智能 駕駛	AI及高性能計算及高 端通信

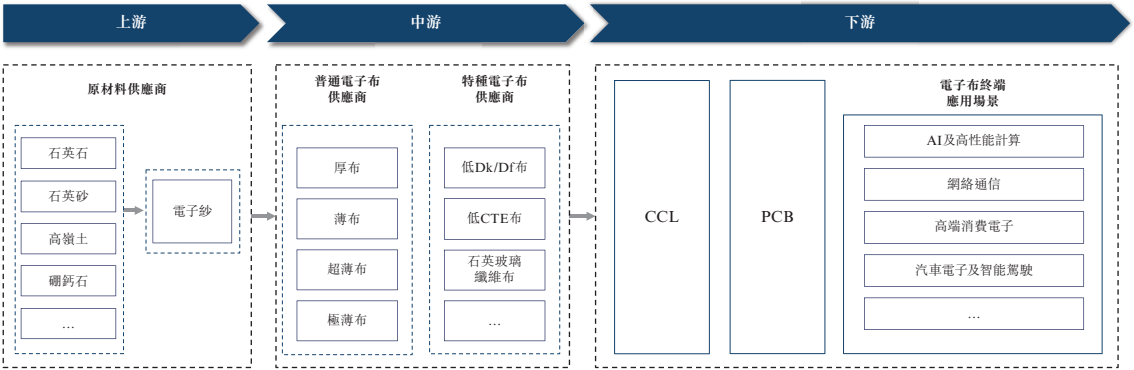
資料來源：沙利文研究

全球電子布市場價值鏈分析

電子布的產業鏈較長，產業鏈直接上游行業為電子紗行業，直接下游行業為覆銅板行業，而電子紗上游可延伸至高嶺土、石灰石、硼鈣石等核心原材料，覆銅板下游可延伸至印製電路板及其應用終端，如AI及高性能計算、消費電子、汽車電子、網絡通信等終端領域。

電子布的產業鏈上游為原材料供應商，其中電子紗作為電子布的主要原材料，佔電子布總成本約50%–75%。產業鏈中游為電子布的研發與製造，不同厚度與性能的電子布產品的生產技術要求不同。產業鏈下游為覆銅板及印製電路板廠商。電子布為覆銅板主要原材料之一，而覆銅板為印製電路板的重要上游原材料。AI及高性能計算、消費電子、汽車電子等廣闊的應用市場為印製電路板及覆銅板帶來大量需求，帶動電子布總體需求上升。

全球電子布市場價值鏈



資料來源：沙利文研究

行業概覽

全球電子布主要終端產品分析

覆銅板

覆銅板是電子布最主要的直接下游應用產品，而不同類型的電子布對應著差異化的應用場景。普通電子布憑藉其成熟的工藝、穩定的介電性能和機械強度，能夠滿足大多數普通信號傳輸需求，因此被廣泛適配於通用的印製電路板製造流程。而在更高階的應用中，為應對高頻高速信號傳輸帶來的挑戰，行業開始普遍採用低Dk/Df布及石英玻璃纖維布等特種材料，其核心優勢在於能大幅降低信號的傳輸損耗與干擾，從而保證信號完整性。同樣，在BT和ABF材料等需要嚴苛尺寸穩定性的特定IC封裝基板中，材料的耐熱循環能力要求較高，低CTE布便成為理想選擇，它能夠有效抑制熱應力帶來的形變，確保在複雜工況下仍具備優異的可靠性。

印製電路板

在印製電路板的眾多應用圖譜中，常規的單層及雙層板作為最基礎的形態，廣泛覆蓋消費電子、家用電器及工業控制等領域。此類產品對信號傳輸的要求相對常規，因此普通電子布配合成熟的製造工藝，以高性價比滿足了大規模量產的需求，構成了電子產業普適性應用的基石。然而，隨著電子設備向高速、高密度、高可靠方向演進，PCB技術亦分化出多個高階種類，對電子布的性能提出了不同的專業化要求，驅動材料體系從普通型向特種功能型轉變。

- **高多層PCB**：高多層PCB層數高、信號鏈路長，對材料的一致性和可靠性要求突出，以極薄布、低Dk/Df布以及石英玻璃纖維布為主，極薄布的尺寸優勢使高多層PCB能夠在保證機械強度的情況下傳輸信號。低Dk/Df布的低介電損耗特性可顯著提升高多層PCB的系統穩定性並降低能耗，提高信號傳輸效率。石英玻璃纖維布憑藉極低介電系數和優異的介電穩定性，滿足超高速、高頻信號傳輸需求，也是高多層PCB的重要材料選擇。
- **高階HDI PCB**：高階HDI PCB以高密度互連和精細線路為特徵，對電子布厚度均勻性與表面平整度要求高，通常採用極薄布、超薄布、低Dk/Df布或石英玻璃纖維布。低Dk/Df布的低介電損耗特性可有效降低高速信號傳輸中的衰減與延遲，而極薄布及超薄布支持更多層數，並提供更多功能，是高階HDI PCB不可或缺的基礎材料。

行業概覽

- **先進IC封裝基板：**IC封裝基板是先進IC封裝的核心載體，對尺寸穩定性、熱可靠性和信號完整性要求嚴苛，依賴於極薄布、低CTE布。極薄布憑藉其極薄性質與尺寸穩定性，成為先進IC封裝基板的核心材料。低CTE布可將CTE降至合理水平，緩解熱循環下的翹曲風險。

以收入計，全球PCB市場規模從2021年的76.9十億美元增長至2025年的86.7十億美元，2021年至2025年期間的複合年增長率為3.0%。其中，高多層PCB、高階HDI及先進IC封裝基板的市場規模從2021年的11.8十億美元、5.1十億美元及13.6十億美元增長至2025年的14.8十億美元、7.5十億美元及15.0十億美元，2021年至2025年期間的複合年增長率為5.8%、10.0%及2.5%。

預計到2030年全球PCB市場規模將達到118.5十億美元，2025年至2030年期間的複合年增長率為6.4%，其中，高多層PCB、高階HDI及IC封裝基板的市場規模預計將增長至22.1十億、12.2十億及21.7十億美元，2025年至2030年期間的複合年增長率為8.4%、10.3%及7.7%。隨著PCB向高頻高速、高多層及高可靠性方向演進，其對關鍵原材料性能要求顯著提升，而特種電子布具備低介電常數與介電損耗、優異尺寸穩定性及一致性的特點，足以滿足高速信號傳輸與精密製造需求。

終端應用場景

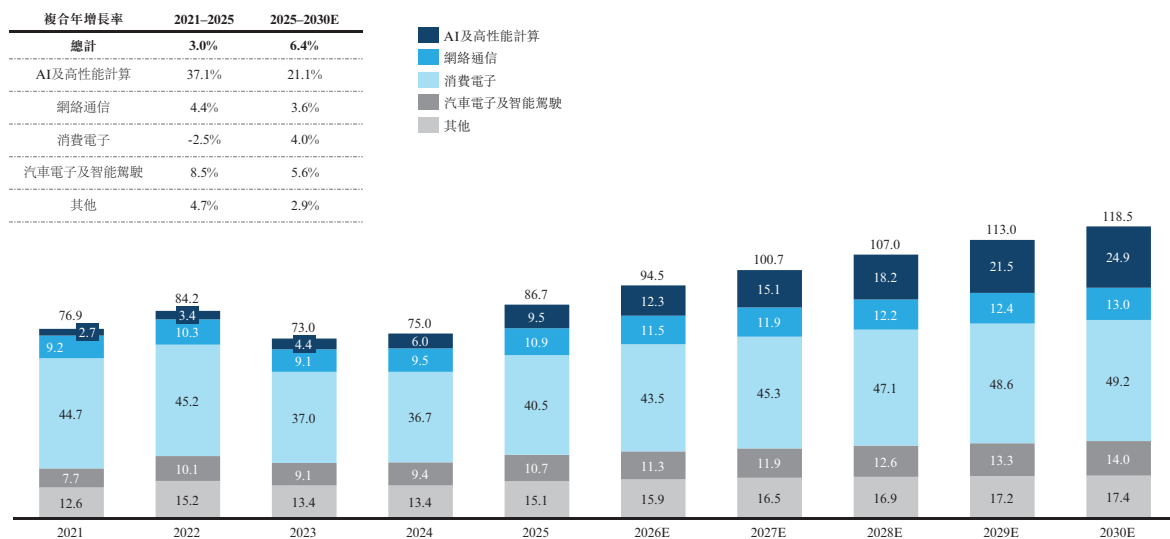
- **AI及高性能計算：**隨著人工智能等前沿技術的快速發展，為滿足日益增長的算力需求，全球各地區持續加大算力基礎設施的建設及升級迭代工作。2025年，全球AI服務器的出貨量在2.5百萬台。預計全球AI服務器出貨量將於2030年達到6.8百萬台，2025年至2030年期間全球AI服務器出貨量的複合年增長率為22.2%。AI服務器對高速、低延遲與高可靠度的數據傳輸提出更高要求，促使PCB在集成密度、信號完整性與散熱性能上持續升級，進一步推動特種電子布的需求持續增長。
- **網路通信：**高頻信號傳輸需求與數據流量激增，大幅拉動了高多層PCB的市場需求。低損耗、高均勻度特種電子布，可有效支撐高速高頻信號穩定傳輸，為網路通信設備的可靠運行奠定關鍵基礎。
- **高端消費電子：**隨著人工智能手機、人工智能個人電腦等智能終端產品持續升級，終端對算力及高速數據處理能力的需求大幅提升；疊加終端產品小型化發展趨勢，要求印製電路板具備高集成度、尺寸穩定性與可靠性，並可支持高速、低延遲信號傳輸。此舉帶動市場對小批量、高規格特種電子布(包括超薄布、極薄布及低CTE布)的需求，此類產品能有效提升熱穩定性及尺寸穩定性。

行業概覽

- **汽車電子及智能駕駛：**新能源汽車普及與智能駕駛技術發展，持續提升車載電子系統的複雜程度，對印製電路板在可靠性、高速信號處理及熱管理方面提出了更高要求。汽車電子普遍採用高多層PCB，以滿足複雜佈線及高速數據交互需求，並使用極薄布與超薄布提升佈線密度及加工精度。智能駕駛芯片封裝所用的IC封裝基板大多採用低CTE布，用以降低熱應力、抑制形變，並增強長期運行穩定性。

按不同下游應用領域劃分，以收入計，2025年全球PCB市場在AI及高性能計算、網絡通信、消費電子和汽車電子及智能駕駛應用領域下分別達到9.5十億美元、10.9十億美元、40.5十億美元、10.7十億美元。特別是，隨著近年來全球雲計算以及AI技術和相關應用的快速發展，服務器、數據中心等雲基礎設施的需求持續擴大，推動PCB產品在AI領域方面的用量相應增加。全球PCB市場在AI及高性能計算領域下的市場規模進一步增長至2030年的24.9十億美元，2025年至2030年期間的複合年增長率達到21.1%。

全球PCB市場規模，按應用劃分，以收入計(十億美元，2021–2030E)



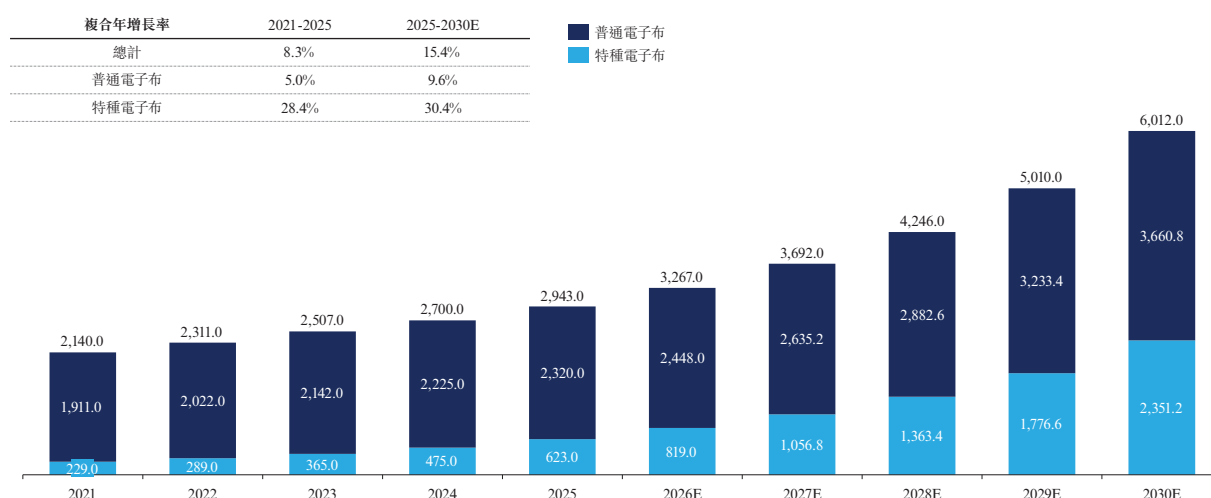
資料來源：沙利文研究

全球電子布市場規模

以收入計，全球電子布市場規模從2021年的2,140.0百萬美元增長至2025年的2,943.0百萬美元，2021年至2025年期間的複合年增長率為8.3%。全球電子布市場規模預計將於2030年增長至6,012.0百萬美元，2025年至2030年期間的複合年增長率為15.4%。

行業概覽

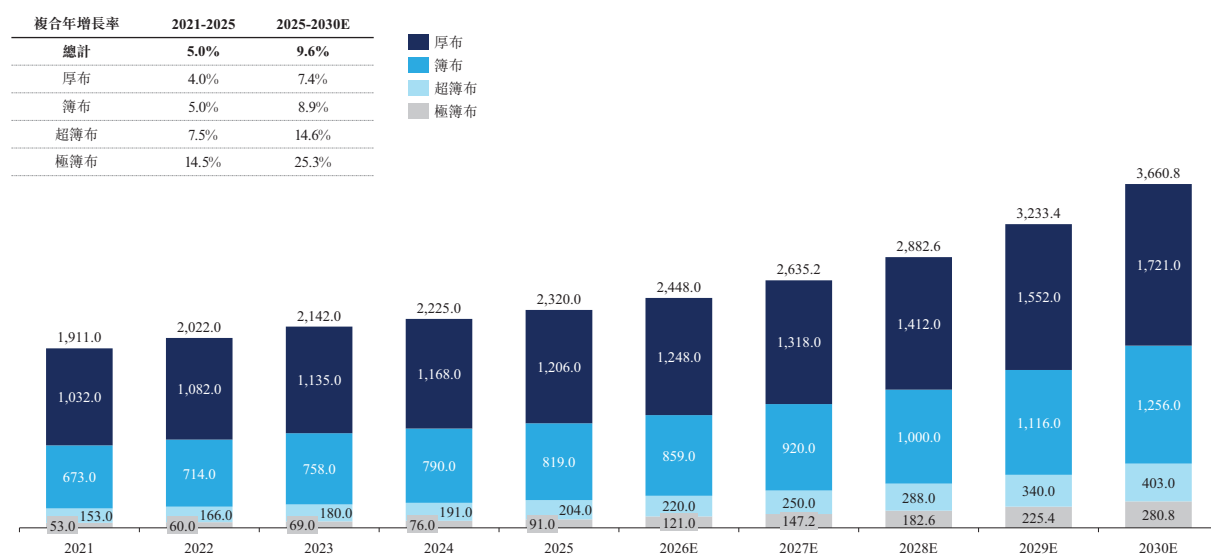
全球電子布市場規模，按產品類型劃分，以收入計(百萬美元，2021–2030E)



資料來源：沙利文研究

以收入計，全球普通電子布市場從2021年的1,911.0百萬美元增長至2025年的2,320.0百萬美元，2021年至2025年期間的複合年增長率為5.0%。根據電子布的厚度劃分，2025年全球厚布、薄布、超薄布與極薄布的市場規模分別達1,206.0百萬美元、819.0百萬美元、204.0百萬美元、91.0百萬美元，其中全球超薄布與極薄布市場規模佔總市場規模的比例分別達到8.8%、3.9%。全球普通電子布預計將於2030年增長至3,660.8百萬美元，2025年至2030年期間全球普通電子布市場規模的複合年增長率為9.6%，到2030年，全球超薄布與極薄布的市場規模分別為403.0百萬美元、280.8百萬美元，佔總市場規模的比例分別達到11.0%、7.7%，2025年至2030年期間全球超薄布和極薄布的複合年增長率分別達到14.6%和25.3%。

全球普通電子布市場規模，按產品類型劃分，以收入計(百萬美元，2021–2030E)

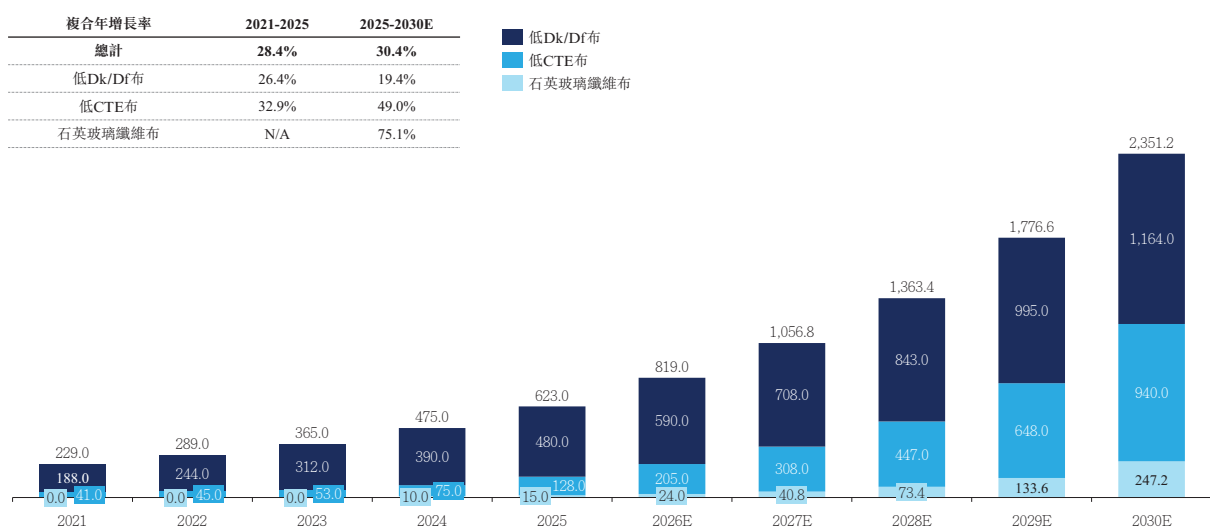


資料來源：沙利文研究

行業概覽

以收入計，全球特種電子布市場從2021年的229.0百萬美元增長至2025年的623.0百萬美元，2021年至2025年期間的複合年增長率為28.4%。2021年至2025年，全球低Dk/Df布市場規模由188.0百萬美元增長至480.0百萬美元，複合年增長率達26.4%；同期全球低CTE布市場規模由41.0百萬美元增長至128.0百萬美元，複合年增長率達32.9%。其中，2025年二代低Dk/Df布的市場規模達到70.0百萬美元，佔低Dk/Df布總市場規模的14.6%，2021年至CTE2025年期間複合年增長率為36.8%。全球特種電子布市場規模預計將於2030年增長至2,351.2百萬美元，2025年至2030年期間的複合年增長率為30.4%。其中，全球低Dk/Df布和CTE布市場2025年至2030年期間的複合年增長率分別達到19.4%和49.0%。二代低Dk/Df布作為滿足性能要求的關鍵材料，預計2030年市場規模將達到350.0百萬美元，佔低Dk/Df布總市場規模的30.0%，2025年至2030年期間複合年增長率為37.9%。

全球特種電子布市場規模，按產品類型劃分，以收入計(百萬美元，2021–2030E)



資料來源：沙利文研究

全球電子布市場的驅動因素及發展趨勢

- 高端應用場景驅動需求增長：**在AI服務器及數據中心領域，隨著算力密度提升及數據傳輸速率提高，高速高頻PCB對材料性能提出更高要求。低Dk/Df布可以有效降低信號傳輸損耗，提升信號傳輸穩定性。同時，隨著芯片出貨量增加及封裝尺寸擴大，IC封裝基板對材料穩定性的要求進一步提升。低CTE布能夠降低材料熱失配帶來的風險，成為電子布性能升級的重要方向之一。此外，隨著智能手機、平板電腦、可穿戴設備及其他消費電子產品持續向輕薄化及高集成度方向發展，PCB對厚度控制及尺寸穩定性的要求不斷提高，推動電子布向超薄型、極薄型方向發展，以滿足高佈線密度與緊湊化結構設計需求。消費電子產品更新迭代速度加快，對高性能PCB的需求持續增長，進一步帶動電子布市場需求提升。

行業概覽

- **核心技術研發推動產品升級：**通過研發低熱膨脹系數配方，並結合極細纖維拉絲技術，電子布在保持物理強度的同時實現了電氣性能的質變。同時，隨著精密織造與開纖處理技術的成熟，電子布的平整度和布面厚度控制達到了微米級水平，有效解決了高頻信號傳輸中的相位差與阻抗控制難題。核心技術的突破不僅滿足了高速高頻CCL和高端PCB產品對材料嚴格的穩定性要求，也支撐了電子布向高附加值領域的滲透。核心技術的持續研發不斷催生出新的電子布產品品類，通過提升材料的適用邊界，直接推動了特種電子布的需求發展。
- **低Dk/Df材料成為重要發展方向：**隨著AI服務器、數據中心及高速通信設備對信號傳輸速率與穩定性的要求不斷提升，PCB材料對介電常數與介電損耗的要求持續提高。低Dk/Df布可有效降低信號傳輸過程中的損耗與延遲，提升信號完整性，正逐步成為高端PCB的重要材料方向。第二代低Dk/Df布在介電性能方面進一步優化，相較一代低Dk/Df布具備更低的介電常數及介電損耗因子，有助於降低傳輸過程中的信號損耗。此外，以高純石英纖維為代表的石英玻璃纖維布具備極低介電損耗與優異電氣性能，已在部分高端場景中實現試點應用。
- **低CTE材料需求增長：**在芯片封裝尺寸不斷擴大及算力密度持續提升的背景下，先進IC封裝基板在熱循環過程中面臨更為嚴苛的可靠性要求。低CTE布可有效降低材料間的熱失配，減少翹曲風險，從而提升產品的長期穩定性與可靠性。隨著先進IC封裝及AI服務器等應用場景的發展，對低CTE布的需求持續增長。

電子布成本分析

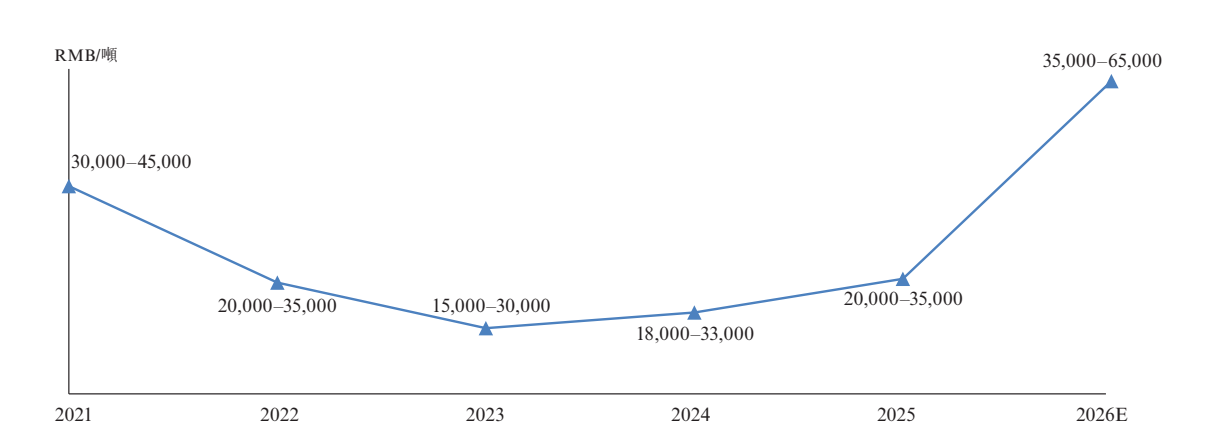
電子布的核心成本構成為電子紗，通常佔其生產成本的50%–75%。在超簿布及極簿布等高性能產品中，由於對材料性能及厚度控制要求更高，成本佔比通常更高。電子紗的性能又直接影響電子布的強度、穩定性及加工適配性，尤其在超細紗及極細紗產品中，對工藝控制能力要求更高。

電子紗單價整體呈現先下降後回升的波動趨勢。受下游需求波動及行業產能階段性釋放影響，電子紗價格一度降低，並在2023年前後出現明顯下降趨勢。隨著供需格局改善以及特種電子紗產品的佔比提升，電子紗的價格逐步上升。

作為通用電子布類別中薄型布的核心原材料，D450的價格走勢對整個電子布行業的整體價格變動具有高度代表性。由於行業產能在前期集中釋放導致短期供應過剩，加上下游消費電子行業需求疲弱，D450電子紗的價格由2021年每噸人民幣30,000至45,000元持續下跌至2023年每噸人民幣15,000至30,000元。在供需結構優化的推動下，預計D450電子紗的價格將逐步回升，於2024年反彈至每噸人民幣18,000至33,000元，並於2025年達至每噸人民幣20,000至35,000元。展望未來，隨著電子布的需求持續上升，預計到2026年D450電子紗的價格將達至每噸人民幣35,000至65,000元，並預期未來將維持於較高價格區間，從而推動電子布成本上升。

行業概覽

2021–2026年預計D450電子紗價格分析



來源：弗若斯特沙利文

全球電子布市場競爭格局

全球電子布市場競爭激烈且相對集中。2025年，全球共有超過40家電子布廠商。以2025年超薄布的收入規模計，本公司在全球電子布市場中排名第二，在中國內地廠商中排名第一，市佔率達到13.3%。以2025年極薄布的收入規模計，本公司在全球電子布市場中排名第一，市佔率達到36.7%。以2025年超薄布及極薄布加總後的收入規模計，本公司在全球電子布市場中排名第一，市佔率達到20.5%。

2025年全球電子布頂級供應商市場排名，以超薄布和極薄布收入計

按超薄電子布收入計					按極薄電子布收入計				
排名	供應商	總部	收入 (人民幣 百萬元)	市場 佔有率 (%)	排名	供應商	總部	收入 (人民幣 百萬元)	市場 佔有率 (%)
1	A公司	中國台灣	203.0	14.2%	1	本公司	中國內地	233.8	36.7%
2	本公司	中國內地	189.2	13.3%	2	A公司	中國台灣	142.0	22.3%
3	B公司	中國台灣	176.0	12.3%	3	C公司	日本	85.0	13.4%
4	C公司	日本	158.0	11.1%	4	E公司	日本	37.0	5.9%
5	D公司	中國內地	146.0	10.2%	5	F公司	中國內地	30.0	4.7%

附註：

- (1) A公司是一家於1964年成立的上市公司，於台灣證券交易所掛牌上市，總部位於中國台灣省，主營玻璃製品。
- (2) B公司是一家於1958年成立的上市公司，於台灣證券交易所掛牌上市，總部位於中國台灣省，主營塑膠加工製品、化工產品、電子布、聚酯纖維及相關工程服務。
- (3) C公司是一家於1923年成立的上市公司，於東京證券交易所掛牌上市，總部位於日本，主營電子材料。
- (4) D公司是一家於1991年成立的上市公司，於深圳證券交易所掛牌上市，總部位於中國內地，主營玻璃纖維及複合材料製品。
- (5) E公司是一家於1931年成立的上市公司，於東京證券交易所掛牌上市，總部位於日本，主營多元化化工及材料產品。
- (6) F公司是一家於2011年成立的非上市公司，總部位於中國內地，主營電子布產品。

資料來源：沙利文研究

行業概覽

以2025年低Dk/Df布的收入規模計，本公司在全球電子布市場中排名第七，在中國內地廠商中排名第一，市佔率達到4.0%。以2025年低熱膨脹系數布的收入規模計，本公司在全球電子布市場中排名第三，在中國內地廠商中排名第一，市佔率達到5.0%。以低熱膨脹系數布收入規模的增速計，2025年第四季度至2026年第一季度，本公司環比增長190.8%，在全球電子布市場中排名第一。

2025年全球電子布頂級供應商排名，按低Dk/Df 布和低CTE布收入計

按低Dk/Df布收入計					按低CTE布收入計				
排名	供應商	總部	收入 (人民幣 百萬元)	市場 佔有率 (%)	排名	供應商	總部	收入 (人民幣 百萬元)	市場 佔有率 (%)
1	C公司	日本	1,186.0	35.3%	1	C公司	日本	622.0	69.4%
2	E公司	日本	668.0	20.0%	2	I公司	日本	111.0	12.4%
3	G公司	中國內地	443.0	13.2%	3	本公司	中國內地	44.9	5.0%
4	A公司	中國台灣	426.0	12.7%					
5	H公司	中國台灣	239.0	7.1%					
6	F公司	中國內地	136.0	4.1%					
7	本公司	中國內地	133.1	4.0%					

附註：

- (1) G公司是一家於1997年成立的非上市公司，總部位於中國內地，主營玻璃纖維及其製品。
- (2) H公司是一家於1999年成立的上市公司，於櫃檯買賣中心掛牌上市，總部位於中國台灣省，主營電子布業務。
- (3) I公司是一家於1889年成立的上市公司，於東京證券交易所掛牌上市，總部位於日本，主營高分子材料及電子布產品。

資料來源：沙利文研究

全球電子布市場關鍵成功因素及進入壁壘

- **技術與研發：**電子布行業屬於技術密集型行業，技術壁壘較高。電子布的生產涉及池窯結構設計、拉絲工藝控制以及織造工藝優化等多項關鍵技術，對玻璃配方穩定性、纖維直徑均勻性及紗線性能一致性均提出較高要求。同時，電子布須在結構均勻性、尺寸穩定性及表面平整度等方面滿足PCB製造的要求，並在力學性能、熱穩定性及長期可靠性等方面保持穩定表現。整體生產技術體系複雜，對企業的技術研發能力及工藝控制能力提出較高要求，從而形成較高的行業進入壁壘。
- **客戶認證與品牌：**電子布作為覆銅板及印製電路板製造的重要基礎材料，須經過覆銅板及印製電路板產品廠商的多層測試與驗證，包括但不限於性能表現、長期穩定性及供應體系審核等環節。高端的應用場景對特種電子布的要求更為嚴格，供應商需具備長期穩定供貨能力與成熟質量管理經驗。完成認證後，客戶更換供應商需重新進行測試評估，時間成本與使用風險較高，使既有供應商形成較強客戶黏性。隨著穩定交付經驗不斷積累，產品可靠性逐步轉化為客戶信任基礎，領先廠商由此在高端市場建立持續競爭優勢，新進入者難以在短期內獲得核心客戶認可。

行業概覽

- **製造：**行業所需的核心設備技術要求高、交付週期較長。設備在實際生產中的穩定運行還依賴企業持續的調試與優化經驗，領先企業往往通過長期積累不斷進行設備改造和參數優化，從而在效率和產品穩定性上形成優勢。同時，電子布生產涉及拉絲、織造以及後後處理等多道工序，各環節之間需要穩定銜接，對設備協同與流程管理能力要求較高，以保障產品質量的一致性及生產過程的持續穩定運行。部分企業通過構建從電子紗到電子布的一體化生產體系，對關鍵工藝參數進行系統化管理，從而提升產品性能穩定性並更好滿足下游客戶需求。相比之下，新進入者短期內難以建立成熟穩定的製造體系，因此製造能力及一體化生產水平構成電子布行業的重要進入壁壘之一。
- **人才：**電子布尤其是特種電子布的開發與量產高度依賴長期積累的专业技術與管理團隊，涵蓋玻纖配方設計、拉絲、織造後處理優化及質量體系管理等多個關鍵環節。高端產品性能的提升並非單一設備升級即可實現，而是建立在對材料體系與工藝窗口的深度理解以及長期運行經驗的沉澱之上。相關核心技術人員培養週期較長，需要兼具材料學背景與產業化實踐經驗，難以通過短期引進快速形成能力。通過完善的培訓與激勵機制保持團隊穩定性與協同效率，形成持續迭代的技術積累與組織優勢。

資料來源

本公司委託全球獨立諮詢機構弗若斯特沙利文開展全球電子布市場的詳細研究與分析。該機構主營行業研究、市場策略制定、增長諮詢及企業培訓等服務。本公司已同意就編製弗若斯特沙利文報告，向其支付費用人民幣600,000元。本公司於本節、概要、業務、財務資料以及本文件其他章節中，摘錄了弗若斯特沙利文報告中的若干內容，旨在向潛在[編纂]更全面地介紹本公司所處行業概況。編製弗若斯特沙利文報告期間，弗若斯特沙利文同時開展一手研究及二手研究，獲取目標研究市場的行業趨勢、相關統計數據、行業資料及專業見解。一手研究主要與行業龍頭企業及業內專家訪談交流，瞭解市場發展現狀。

二手研究則查閱企業報告、獨立研究報告，並參考弗若斯特沙利文自有資料庫資料。弗若斯特沙利文已對相關資料進行獨立核實，但其研究結論的準確性在很大程度上依賴於所收集資料本身的準確性。弗若斯特沙利文的研究亦可能受其所採用假設的合理性、以及一手及二手資料來源選擇的影響。

弗若斯特沙利文報告基於以下假設編製：(i)短期內中國內地及全球經濟有望維持穩健增長；(ii) 2025年至2030年，中國內地及全球社會、經濟及政治環境預計保持穩定。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

行業概覽

本公司董事確認，經作出合理查詢後，自弗若斯特沙利文報告日期以來，市場資料並無出現任何會變更、抵觸或重大影響該報告所載資料的不利變動。